

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年04月25日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：杨朝辉先生 副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东先生 副总经理：吕洪杰先生 独立董事：丘运良先生 保荐代表人：吴斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问大族数控一季度毛利率变化的主要原因是什么？怎么展望未来的毛利率变化？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司一季度毛利率变化主要是因为销售产品的结构变化，加上市场竞争加剧导致。未来公司将继续加强研发投入，提升产品竞争力和盈利能力。谢谢！</p> <p>2、请问随着手机等消费电子触底反弹，今年以来下游需求有没有出现回暖的迹象？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！得益于消费类电子市场局部回暖、新能源汽车电子技术升级及AI服务器需求强劲，相应的PCB产品需求增加，拉动了下游客户的资本支出，公司相应的专用加工设备需求增长显著，公司2024年一季度营收获得较大幅度增长。谢谢！</p>

3、Q1净利润增长21%，请问领导对2024年全年如何展望。

答:尊敬的投资者，您好！受AI产业链驱动，加上消费电子终端库存逐步消化，Prismark预测2024年的全球PCB产业重归成长通道，增长幅度可达5%，并对行业的中长期维持积极展望，预估2023-2028年PCB行业营收复合增长率为5.4%，产量的复合增长率更是高达6.8%，预计将积极推动下游客户的投资规模。公司作为行业专用加工设备的领先企业，可有效把握市场需求增长带来的商机，持续多层板市场拓展，加快发展新质生产力，紧跟高附加值市场的需求，实现高水平的国产化替代，加速海外市场的拓展，把握PCB产业转移机遇。谢谢！

4、面对全球经济不确定性，准备采取哪些措施来应对潜在的市场风险？

答:尊敬的投资者，您好！公司将密切关注宏观经济的变化情况，坚持PCB行业最新技术的研发，积极开拓产品应用场景，巩固公司的竞争优势，以增强应对市场变化的能力。谢谢！

5、请问领导对于公司的未来有何展望？对于投资者有哪些建议？

答:尊敬的投资者，您好！受AI产业链驱动，加上消费电子终端库存逐步消化，Prismark预测2024年的全球PCB产业重归成长通道，增长幅度可达5%，并对行业的中长期维持积极展望，预估2023-2028年PCB行业营收复合增长率为5.4%，产量的复合增长率更是高达6.8%，预计将积极推动下游客户的投资规模。公司作为行业专用加工设备的领先企业，可有效把握市场需求增长带来的商机，持续多层板市场拓展，加快发展新质生产力，紧跟高附加值市场的需求，实现高水平的国产化替代，加速海外市场的拓展，把握PCB产业转移机遇。建议投资者持续关注优质、头部上市公司发展，并进行理性投资。谢谢！

6、针对海外销售市场，公司主要采取了哪些市场拓展策略？

答:尊敬的投资者，您好！在国际贸易摩擦持续情况下，供应链的重塑掀起东南亚国家的PCB产业扩产潮，公司积极应对产业转移机遇，与现有国内合作客户深度布局东南亚市场。在加强海外代理商合作的基础上，重点与国内结盟客户共同布局，针对当地商业模式、供应链体系、人才状况等制定适合的产业发展规划；并设立海外公司，建立本土化的运营团队，凭借在该市场的竞争优势把握产业转移带来的商机。谢谢！

7、去年收入、利润双降，麻烦介绍一下今年的客户环境评估，以

及未来新产品的介绍。

答:尊敬的投资者,您好!受AI产业链驱动,加上消费电子终端库存逐步消化,Prismark预测2024年的全球PCB产业重归成长通道,增长幅度可达5%,并对行业的中长期维持积极展望,预估2023-2028年PCB行业营收复合增长率为5.4%,产量的复合增长率更是高达6.8%。未来,公司将持续加大在多层板市场工艺解决方案的创新,结合设备、工艺参数、加工工具及原辅料等提供最优综合成本的方案,如机械钻孔方面,公司通过提升主轴转速、优化进刀参数,搭配涂层钻咀等大幅降低钻孔工序的千孔成本,并充分挖掘现有产品上下游工序的价值,持续丰富产品矩阵。此外,公司将不断拓展微小孔激光钻孔机、高精度控深激光成型机在先进封装FC-BGA领域的应用,加快微小线路图形转移方案的落地,促进国内Chiplet封装的产业化应用。谢谢!

8、请问公司在ESG领域做了哪些工作?

答:尊敬的投资者,您好!关于环境、社会责任和公司治理等信息详见公司定期报告。公司重视可持续发展,勇担社会责任,为客户创造价值,与员工共同成长,努力回报投资者,以科学发展促进社会的和谐与进步。未来,公司将继续践行可持续发展理念,向优秀的企业学习借鉴,在环境保护、公司治理、社会责任等方面做出努力。感谢您的关注!

9、公司股价在过去一年波动较大,请问是否有计划通过回购股份或其他方式稳定股价呢

答:尊敬的投资者,您好!公司后续如有回购计划或稳定股价的其他措施,将根据相关规定履行信息披露义务,请您关注公司相关公告,谢谢。

10、与同行业可比公司相比,公司的核心竞争力是什么?

答:尊敬的投资者,您好!与行业内大部分企业有所区别,公司凭借对高速高精运动控制、精密机械、软件算法、图像处理、CAE数字动态仿真等先进技术的综合运用,已拓展钻孔、曝光、成型、检测等多个PCB关键工序及多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分市场,由此形成了应用场景、客户、产品、技术、供应链的多维协同,创造性地发挥协同优势,放大客户、供应链伙伴、公司各组织的价值。并通过不断的关键技术突破及产品迭代,不断完善和优化产品结构,促进公司构建的覆盖不同细分PCB市场及工序的立体化产品矩阵日趋成熟,持续保持公司产品领先的市场地位。感谢

	<p>您的关注！</p> <p>11、请问公司如何识别和管理业务风险？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司制定的《风险和机遇识别评价控制程序》，可对业务风险进行识别、评估、预警和应对。公司强调风险组合管理，结合内、外部因素不断进行优化，加强风险管理与内部控制管理协调统一，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力。谢谢！</p> <p>以上为公司2023年度业绩网上说明会交流内容节选，投资者可通过回看链接浏览说明会详情。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年04月25日